

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

**自願性公告 —
建議收購的最新情況**

茲提述本公司就(其中包括)其加盟為建議收購STATS ChipPAC而合組之聯合體而於二零一四年十二月二十二日刊發的公告(「該公告」)。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙具該公告所賦予的涵義。

本公司謹此提述德意志銀行新加坡分行及中國國際金融(新加坡)有限公司代表聯合體JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.(即競投公司)就(其中包括)建議收購於二零一四年十二月三十日在新加坡證券交易所刊發的附帶先決條件自願性全面要約公告(「競投公司先決條件公告」)。

據競投公司先決條件公告所示，競投公司將提呈自願性有條件要約(「要約」)，收購STATS ChipPAC股本中所有已發行及繳足普通股(不包括庫存股以及競投公司和有關連人士擁有、控制或同意收購的股份)，惟前提是必須達成或獲豁免達成若干先決條件(「先決條件」)。先決條件包括長電科技股東批准要約、STATS ChipPAC股東批准(i)內部重組步驟、(ii)分派其擬成立以持有其若干附屬公司的新附屬公司的全部股份((i)及(ii)統稱「股本削減」)和(iii)向STATS ChipPAC股東發行永久證券(「永久證券發行」、新加坡高等法院批准股本削減、STATS ChipPAC的綜合總債務不超出若干上限以及獲得相關授權。

要約附帶以下條件：涉及股份數目的接納水平連同競投公司擁有、控制或同意收購的股份將使競投公司持有STATS ChipPAC超過50%的投票權、本公司進行永久證券發行及完成股本削減。

要約一旦落實，將以新加坡元進行。如長電科技之前公佈，競投公司就要約應付的最高現金代價總額將為1,025,739,000新加坡元，金額按要約價總額780,000,000美元以及1美元兌1.31505新加坡元之匯率(即二零一四年十二月十九日下午五時正現行之匯率)計算。

倘若任何先決條件未能於二零一五年六月三十日或STATS ChipPAC與競投公司經諮詢新加坡證券行業委員會後可能協定之較後日期下午五時正或之前達成或獲得豁免(視乎情況而定)，要約將不會進行。

競投公司已接獲擁有1,845,715,689股STATS ChipPAC股份(相當於STATS ChipPAC於二零一四年十二月三十日之已發行股本約83.8%)之Singapore Technologies Semiconductors Pte Ltd(「**STSPL**」)發出日期為二零一四年十二月三十日的承諾(「**STSPL承諾**」)。根據STSPL承諾，STSPL承諾(其中包括)根據STSPL承諾之條款(i)接納要約；及(ii)拒絕接納任何競爭性建議或其他要約。

除非先決條件達成或獲得豁免，否則要約不會進行，而先決條件未必會達成或獲得豁免。此外，即使要約進行，要約也不一定會成為或宣佈為無條件。要約會否進行或完成涉及不確定因素。本公司的股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

中芯國際集成電路製造有限公司
邱慈雲博士
首席執行官兼執行董事

中國，上海
二零一四年十二月三十一日

於本公告日期，董事分別為：

執行董事

張文義(董事長)
邱慈雲(首席執行官)
高永崗(首席財務官)

非執行董事

陳山枝(替任董事李永華)
劉遵義(替任董事陳大同)
周杰

獨立非執行董事

William Tudor Brown
馬宏升(Sean Maloney)
孟樸
陳立武
周一華

* 僅供識別